证券代码: 002859 证券简称: 洁美科技 公告编号: 2021-087

债券代码: 128137 债券简称: 洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于调整公司"年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目" 投资规模的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年10月26日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司"年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目"投资规模的议案》,同意公司将原"年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带"产能调整提升至"年产10万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带",并授权公司管理层办理相关手续。

本次投资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组;本项需要提交股东大会 审议。

2016年12月23日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性报告的议案》,将"年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目"调整为募集资金投资项目,项目总投资为3.54亿元,其中一期为公司募集资金投资项目,使用募集资金投资额为1.29亿元,该项目已于2017年7月31日实施完成。在"年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带"项目二期实施过程中,为了顺应市场发展的新变化,配合下游客户的快速扩产,加快实现纸质载带产能快速扩张,公司二期项目引进了更高端的电子专用原纸生产线,产能较原生产线有所提升,同时公司对一期两条电子专用原纸生产线进行了相关技术改造,需要对应新增后端深加工设备,因此项目投资规模及相关内容需要作相应调整,项目产能由原来的"年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带"调整提升至"年产10万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带",项目总投资由3.54亿元增加至6.54亿元,其中一期募投项目"年产2万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带"投资总额1.29亿元未发生变化,技术改造后产能提升至年产

2.8 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带。

2021年10月26日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司"年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目"投资规模的议案》,同意公司将原"年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带"产能调整提升至"年产10万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带",项目总投资由3.54亿元增加至6.54亿元,并授权公司管理层办理相关手续。项目具体情况如下:

一、项目建设必要性

- 1、本项目的实施符合国家造纸和电子元器件产业政策导向,有利于进一步提高 我国薄型载带封装专用原纸的国产化水平,加快造纸行业转型升级。
- 2、本项目的实施有利于提升电子元器件封装用纸质载带原料保障能力。公司纸质载带领域已经具备原材料自主供应和完善的全系列产品配套服务能力,并且已经投入运营了两条纸机生产线及配套后加工车间,而本项目的实施将形成年产 10 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带扩建项目生产能力,将进一步提升公司下游电子元器件封装用纸质载带生产环节的原料保障能力,并进一步提升公司在该领域内的规模效应。项目实施后还将降低国内纸质载带产品成本,带动电子元器件生产、集成电路封装等产业发展带动国内电子元器件相关产业发展。
- 3、本项目的实施有利于企业提升技术研发创新和生产销售能力,增强公司综合竞争力。本项目实施有助于在公司现有具备的纸质载带的原材料自主供应和完善的全系列产品配套服务能力基础上,加大纸质载带整合和技术创新能力,强化销售渠道拓展力度,增大片式电子元器件封装薄型纸质载带生产能力,配套带动下游电子元器件产业发展,进一步提升市场占有率,实现公司在现有主导产品领域的生产、销售、利润持续稳定增长。

二、调整后建设内容及规模

项目名称: 年产 10 万吨电子元器件封装薄型纸质载带扩建项目

项目建设地点:安吉临港经济开发区

总投资: 65,400 万元

建设期:本项目涉及原生产线技改,其中项目一期两条电子专用原纸生产线已经投产,技改产能扩大后需要增加后端深加工设备、项目二期预计2022年8月投产)

建设内容及规模: 本项目建设三条电子专用原纸生产线, 其中项目一期第一条、

第二条电子专用原纸生产线已顺利投产,需要新增配套后端分切、打孔、压孔等生产设备,项目二期新建一条高端电子专用原纸生产线,配套后端分切、打孔、压孔等生产设备,项目完全达产后,可形成年产 10 万吨电子元器件封装薄型纸质载带的生产能力。

三、项目实施对公司的影响

随着电子元器件小型化趋势的加速,公司需要持续优化对应的纸质载带系列产品的品质,不断提高后端高附加值产品的收入比重。该项目的实施将进一步提升公司纸质载带产品品质,持续扩大公司在纸质载带领域的规模优势,满足下游客户的需求,增强公司的综合竞争力。同时,本项目的实施将进一步优化和完善公司的生产基地战略布局,有利于公司在电子信息材料领域的深根细作。

四、项目风险分析及对策

本项目风险主包括市场风险和行业风险。

(1) 市场风险

随着全球电子信息产业的持续稳定发展,相关电子元器件的需求量也呈现稳步上升的趋势。近年来消费电子、新能源汽车和 5G 技术应用的需求激增和加速落地也将带来大量电子元器件封装载带需求。因此,本项目产品市场前景良好,市场风险较小。

我公司将建立完善的产、供、销计算机应用管理系统,通过市场营销人员、市场分析人员、国际互联网等多种方式和渠道,随时掌握国内、国际市场信息,预测市场变化,采取相应措施,抢占市场先机。不断开拓市场空间,不断完善销售策略,建立和完善销售服务网络,扩大出口渠道,提高产品的市场占有率。

(2) 行业风险

新一代信息技术产业是当前高新技术领域的投资热点,相关电子元器件及配套产业也将成为行业热点,因此本项目将面临一定的行业竞争风险。但由于公司在集成电路、片式电子元器件企业配套生产薄型电子载带以及配套原纸产品领域地位突出,具备相当竞争力;本项目产品在研发和生产均具备一定的准入门槛,而公司拥该产品生产的技术,具有较强的技术支撑能力。

公司将不断进行技术改造,挖掘现有设备的潜力,提高产能,形成规模优势,从而使企业在行业竞争中处于领先地位。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议。 特此公告。

> 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会 2021年10月28日